

護銅劑WPF-19

簡介：

各種各樣的防護方法被使用為印製電路板銅箔的保護。然而，其主要的用途在於含有樹酯的有機溶液和錫焊劑互相融合、可以嚴密地被控制。今後，還需要面對環境污染的問題。優點為耐熱、耐濕。

特徵：

可以在銅箔表面形成具有優異耐熱、耐濕性的有機保護膜。

較諸以往的水溶性助焊液，其耐熱性有過之而無不及，即使在複數次的迴焊處理後，仍可確保優異的焊接性。

具有極高度的沾錫擴散性。

適合用於無鉛焊錫的回溶焊接（reflow soldering）

僅需 60~90 秒的處理時間即可形成保護膜。

由於所形成的保護膜極薄而均勻，可以確保銅箔焊接的平滑性，適合用來處理高密度組裝電路板。

由於不含有機溶劑，不具有引火性。

規格：

外觀：藍色透明液狀

比重：1.07±0.01（20℃）

酸鹼值：3.50~3.70（20℃，線上使用時）

：2.90~3.10（20℃，交貨時）

酸價：260±20

有效成分濃度：100±10 %